

Presseinformation

Elektronikfertigung der Zukunft

Antworten auf dem 5. BuS-Fachpodium

Am 16. Juni 2009 veranstaltete die BuS Elektronik ihr 5. Fachpodium, moderiert von Dr. Werner Witte. Neben informativen Vorträgen namhafter externer Referenten und einer interessanten Podiumsdiskussion bot ein Rundgang durch die Fertigung den Gästen die Möglichkeit, modernste Fertigungstechnologien direkt vor Ort zu erleben. Im Anschluss blieb noch Zeit für individuelle Gespräche und zum Austausch von Erfahrungen.

Technologien der Zukunft

Über aktuelle Trends in der Aufbau- und Verbindungstechnik referierte Prof. Mathias Nowotnick, Direktor des Institutes für Gerätesysteme und Schaltungstechnik an der Universität Rostock. Er verwies auf Schwerpunkte der Forschung, wie Miniaturisierung und Systemintegration, die Entwicklung neuer Werkstoffe (z. B. Nanomaterialien) und Technologien (z. B. Mikrowellenlöten für die selektive Erwärmung von Baugruppen), die auch die Elektronikfertigung beeinflussen werden.

So könnte die selektive Kühlung mittels Füllstoffen, die bei höheren Temperaturen schmelzen oder verdampfen, zum Einsatz kommen. Erste Lacke mit schmelzbaren Füllstoffen sind bereits in der Erprobung. Embedded Flip-Chips in der Leiterplatte, die sehr beständig gegen mehrfache Lötzyklen und Reaktionslote sind, wären für die neuen Diffusionslötverfahren geeignet. Mit Reaktionsloten könnten Montagen bei niedriger Temperatur, die dennoch hochtemperaturfeste Lötverbindungen hervorbringen, realisiert werden.

Bauelementemarkt der Zukunft

Folgt der Markt für Bauelemente der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung? Georg Steinberger, Vice President Communication der Avnet EM EMEA und Präsident des FBDI, sieht zumindest den europäischen Komponentenmarkt im Abwärtstrend. Die Umsätze mit Bauelementen sind hier rückläufig. Es wird prognostiziert, dass der europäische Anteil am Elektronikweltmarkt weiter, bis auf 10 %, abnehmen wird. Zwar werden Plattformprodukte vor Ort hergestellt, aber langfristig entwickelt sich Europa immer mehr zum Nischenmarkt. Zahlreiche Bauelementehersteller werden hier zukünftig nur über Vertriebsorganisationen vertreten sein.

Distributoren sind angehalten, ihr Leistungsspektrum zu erweitern, angefangen von der Designunterstützung bis hin zu Lieferkettenlösungen.

Fertigungsstrategien der Zukunft

Warum Kunden durch das OS10-Konzept, dem Outsourcingprogramm der BuS Elektronik, bis heute schon über 65 Mio. Euro eingespart haben, diskutierte Dr. Stephan Weyhe, Geschäftsführer des FED, mit den anwesenden Vertretern der Kunden und Gästen.

Nach wie vor gibt es Unternehmen, die ihre Fertigung weder in Teilen noch komplett auslagern möchten. Diejenigen, die sich aber nach eingehender Überlegung einen leistungsfähigen EMS-Anbieter, wie die BuS Elektronik, als Partner gewählt haben, sind zufrieden mit ihrer Entscheidung. Die Verlagerung der Produktion erweist sich nach ihrer Meinung insbesondere dann als vorteilhaft, wenn kurzfristig mittlere Serien zu produzieren sind, hohe Qualitätsanforderungen bestehen, die hausintern nur mühsam realisiert werden können oder einfach, wenn ein verlässlicher Partner benötigt wird, der die Fertigung in voller Verantwortung übernehmen kann.

Weitere

Informationen

und Kontakt

BuS Elektronik GmbH & Co. KG

Geschäftsführer Dr. Werner J. Maiwald, Dr. Werner Witte,

Jürgen Streubel

Bayern-und-Sachsen-Straße 1

01589 Riesa

Telefon +49 (0)3525 600-60

Telefax +49 (0)3525 600-6666

E-Mail info@bus-elektronik.de

www.bus-elektronik.de